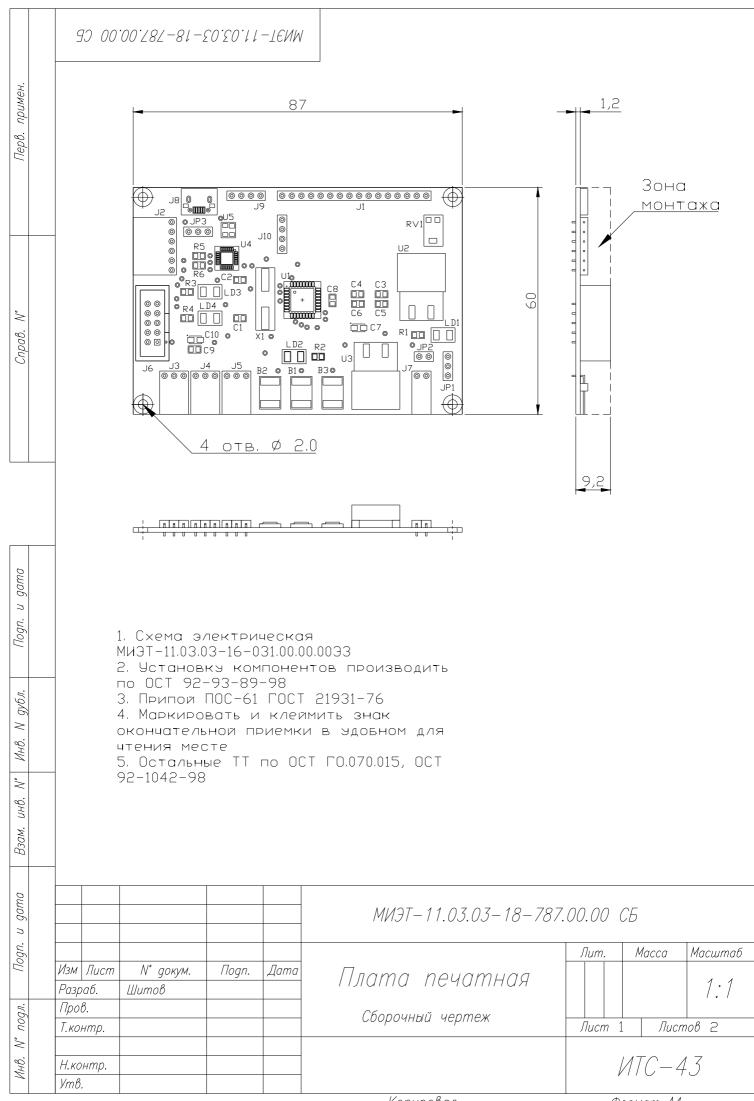


H;	Формат	Лоз.	Обозначение	Наименование <u>Документация</u>	Кол.	Приме- чание	
Перв. примен.	A4		MU9T-11.03.03-18-787.00.00 C5	Сборочный чертеж			
	A3		MUJT-11.03.03-18-787.00.00 33	Схема электрическая			
				принципиальная			
Справ. №	<i>A4</i>		МИЭТ-11.03.03-18-787.00.00 ПЗ	Пояснительная записка			
Cny	<i>A4</i>		МИЭТ-11.03.03-18-787.00.00 ПЭЗ	В Перечень элементов			
	-A3		МИЭТ-11.03.03-18-787.00.00 ВП	Ведомость покупных			
				изделий			
u gama			МИЭТ-11.03.03-18-787.00.00 Д1	3-D модель платы			
Подп. ц				Сборочные единицы			
" дубл.		1	МИЭТ-11.03.03-18-787.00.00 ГЛЭЗ		1		
N° MHB. N°				Прочие изделия			
инв.		2		Датчик угловой скорости	1		
Взам.				MF-10-111-P			
u gama							
Подп.	Изм)	Пист	N° докум. Подпись Дата)		
№ подл.	Разра Пров.	ю.	Шитов	лит. П Т	Лист 1	<i>Листов</i> 3	
Инв.	Н.кон Утвеј				TC-43		

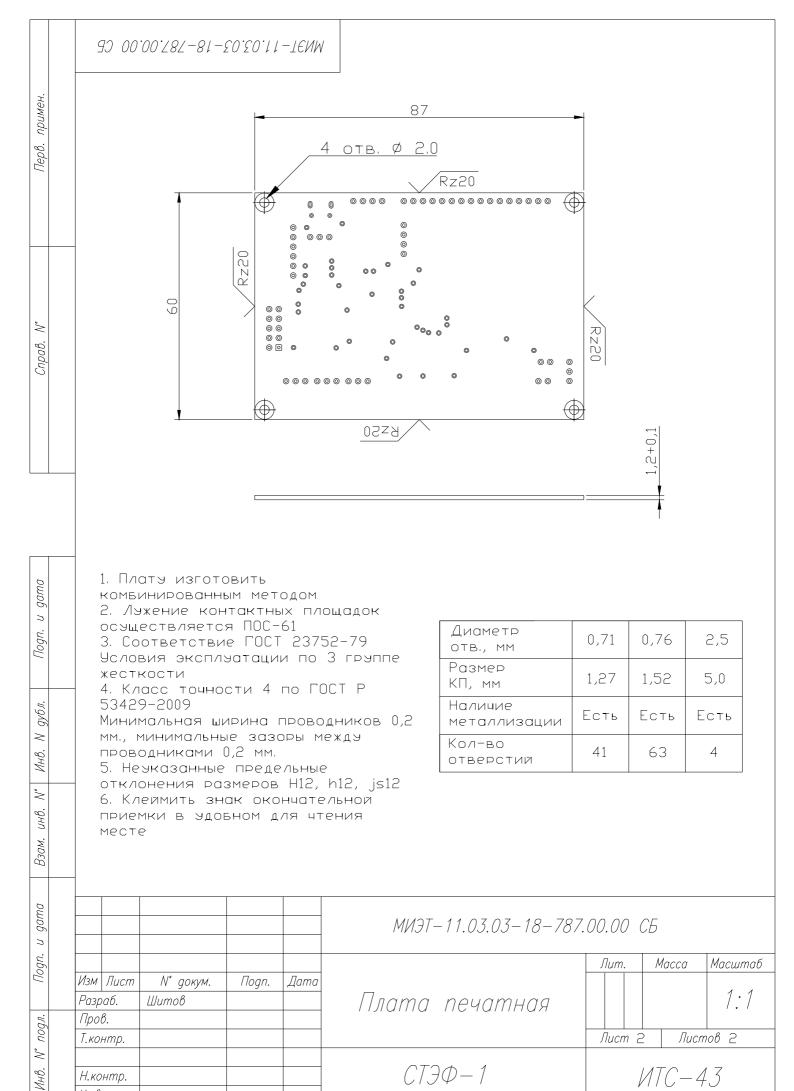
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме чание
				Микроконтроллер		
		3		ATmega8-16AU	1	U1
				Микросхема		
		4		CP2102-GMR	1	U4
				Кварцевый резонатор		
		5		HC-49SM 16.000 MFų	1	X1
				Сборка защитных диодов		
		6		SP0503BAHTG	1	U5
				Стабилизаторы напряжения		
		7		L7805ABD2T-TR 5B	2	<i>U2,U</i>
				Светодиоды		
		9		FM-P3528WDS-460QL-R70	4	LD1L
				Кварцевый резонатор		
		13		HC-49SM 16.000 MFy	1	X1
				Сборка защитных диодов		
		14		SP0503BAHTG	1	U5
				Резисторы		
		15		RC0805FK-07200RL	4	R1R
		19		RC0805FK-0710KL	1	R5
		20		RC0805FK-074R7L	1	R6
		21		3314G-1-103E	1	RV1
				Конденсаторы		
		22		MLCC22pFNP050V5%0805	2	C1, C2
-				МИЭТ—11.03.03—18—787.00.00		Ли

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме чание
		24		Кер. ЧИП 0, 1мкФ X7R, 10%, 1206	3	C3,C8,C
		27		Кер. ЧИП 0,33мкФ 20% X7R 0805	2	C4,C6
		29		TECAP 0,47ΜκΦ20%35B TunA	1	C7
		30		Кер. ЧИП 4,7мкФ X5R 10% 0805	1	C10
				Переключатели		
		31		Кнопка тактовая FSM1LP	3	BT1B
		34		PLS-3 (DS1021) 1x3 mun 1	1	JP1
		35		PLS-2 (DS1021) 1x2 mun 1	1	JP2
				Вилки штыревые		
		36		PLS—16 (DS1021) 1x16 прямая	1	J1
		37		PLS—6 (DS1021) 1x6 прямая	1	J2
		38		PLS—3 (DS1022) 1x3 угловая	3	J3J.
		41		PLS—2 (DS1021) 1x2 прямая	1	J7
		42		PLS—4 (DS1021) 1х4 прямая	2	J9,J1
				Разьемы		
		44		BH-10 (DS1013-10S)	1	J6
		45		Разьем micro USB—B	1	J8
				Цифровые сервоприводы		
		46		Futaba S3156	3	
-		70				
				МИЭТ—11.03.03—18—787.00.00		Лис
Изм	Ли	cm N°	докум. Подпись Дата			



Копировал

Формат А4



Копировал

Утв.

Формат А4

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Стабилизаторы		
<i>U2,U3</i>	Стабилизатор напряжения L7805ABD2T—TR 5B	2	Kopnyc d2pac
	1,5A 2% ST Microelectronics		
	<u>Защитные диоды</u>		
U5	SP0503BAHTG 5B Littelfuse	1	Kopnyc to-253-4
	<u>Переключатели</u>		
BT1BT3	Кнопка тактовая FSM1LP TE Connectivity (Тусо)	3	
JP1	PLS—3 (DS1021) 2.54мм 1x3 прямая тип 1	1	
JP2	PLS—2 (DS1021) 2.54мм 1х2 прямая тип 1	1	
	Вилки штыревые		
J1	PLS—16 (DS1021) 2.54мм 1x16 прямая тип 1	1	
J2	PLS—6 (DS1022) 2.54мм 1x6 угловая тип D1	1	
J3J5	PLS—3 (DS1022) 2.54мм 1х3 угловая тип D1	3	
J7	PLS—2 (DS1021) 2.54мм 1х2 прямая тип 1	1	
J9,J10	PLS—4 (DS1021) 2.54мм 1х4 прямая тип 1	2	
	<u>Разьемы</u>		
J6	BH-10 (DS1013-10S) 2.54мм 2x10 Zhenqin	1	
J8	Разьем micro USB-B 47346-0001 угловой Molex	1	
		<u> </u>	Писп
Изм Лист	N' докум. Подпись Дата	00.00	1133

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

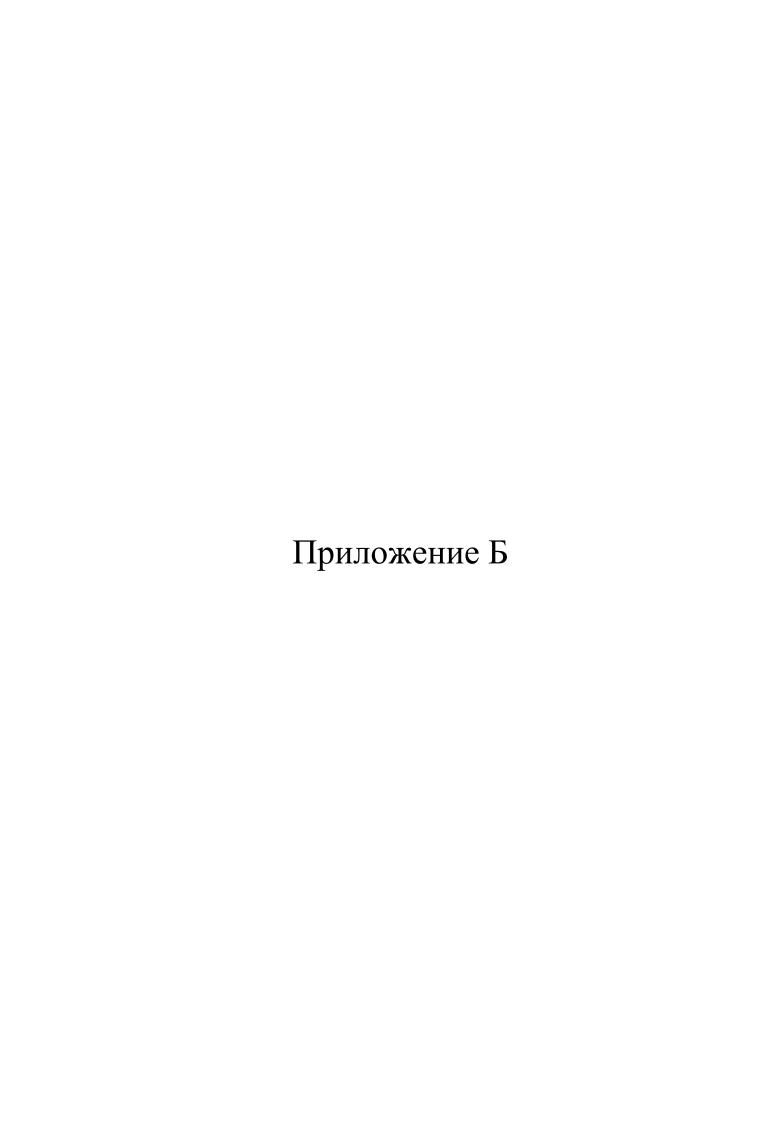
Подп. и дата

Инв. № подл.

	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
H.				
примен.		<u> Микросхемы</u>		
Перв. 1	U1	Микросхема ATmega8—16AU Atmel	1	Kopnyc TQFP-32
	U4	Микросхема CP2102-GMR Silicon Laboratories	1	Kopnyc QFN-28
		<u>Конденсаторы</u>		
	C1,C2	K онденсатор кер. ЧИП 22n Φ $\pm 5\%$ 50B 0805	2	Китай
	C3, C8, C9	Конденсатор кер. ЧИП 0,1мк Φ ±10% 100В 1206		Китай
`	C4,C6	Конденсатор кер. ЧИП 0,33мк Φ $\pm 20\%$ 50В 0805	2	Китай
Справ.	C7	Конденсатор TECAP 0,47мкФ 20% 35B Tun A		Китай
	C10	Конденсатор кер. ЧИП 4,7мкФ 10% 25B 0805 X5R	1	Murata Manufact.
	D1 D1	<u>Резисторы</u>		
	R1R4	Резистор ЧИП 200 Ом 1% 0,125Вт 0805 Тайвань	4	
	R5	Резистор ЧИП 10кОм 1% 0,125Вт 0805 Тайвань	1	
	R6	Резистор ЧИП 4,7кОм 1% 0,125Вт 0805 Тайвань	1	
gama	RV1	Резистор подстроечный SMD 10кОм 20% 0,25Вт 3314G-1-103E Boums		
7		JJ146-1-10JL D0UIIIS		
Nogn.		Chomoguagu		
		CBemoguogus FM D3538WDS 46001 P70 NationStar		
" дубл.	LU1LU4	FM-P3528WDS-460QL-R70 NationStar	4	
Инв. №		<u>Резонаторы кварцевые</u>		
<u>`</u>	X1	Резонатор кварцевый 16.000 МГц HC—49SM	1	Китай
инв.				
Взам.				
00				
u gama				
Подп.	<i>u</i> 5	MU3T-11.03.03-18-78	7.00	1.00 ПЭЗ
3л.	Изм Лист Разраб. Ц	N° докум. Подпись Дата Шитов	Ли	ит. Лист Листов
№ подл.	Пров.	Гиростабилизатор		1 2
Инв. ∧	Н.контр.	Перечень элементов		<i>MTC-43</i>
	Утвердил	Перечень элементой		Danuar 11

Копировал

Формат А4



		_				1		О	CT 11.	.040.019-83	Рорма 4			
													12	
														1
											МИЭ	T.11.03.0	3.18.787	7.(
								<u> </u>		<u> </u>				
						77.6		1						
	+	_	<u>В</u> Г	Цех	Уч.	PM	Опер Обозн	 ачение доку		наименование о	перации			
		H	Д					нование обо		ания				
			T				наименовани							
		_	Л/М			Наиме				и материала				
		\vdash	0		I		l	ие операции						_
			B 01			<u> </u>	030	1		монтаж ко				_
+		_	02	на пе	чатную	плату і	модуля п	рограмм	ирує	емой гирос	габили	заци	И	_
		_	03			<u> </u>	I							_
			Д 04				й дозато	p'ND-35						
			Д 05	_ ^	оскоп А									
			Д 06		_		ьная ста		EME	ENT 702				
-		_	Д 07	Стол	монтаж	ника Р	9A APM	-4110						
			Д 08	Унив	ерсальн	ый циф	ровой м	ультиме	гр М	9508				
			09				<u> </u>							
ŀ		+	T 10	Пинц	ет Инте	рмед Г	I-114							
			T 11	Брасл	тет анти	статич	еский ЈТ	-97-081						
			T 12	Tapa	 техноло	гическ	ая ДМВ	M8.870.0	001					
L			T 13	Боко	резы ТС	PEX 3	2D106							_
			T 14		Ī		і ый элект	ротехни	ческ	 ий.				
			15			1								_
			Л 16	Спира	⊤ Г этилов	_ ый рек	тификов	анный те	ехни	ческий «Эн	стра»	ΓΟΟ	Т	_
			17		78-2013									_
		_	Л 18				т ажные, са	алфетки	(400	х400) мм, (200x20	00) м	м	_
		-	19		Γ 29298-	1			(11 100) 11111, (00) 1.1		
		╬	Л 20		т атки кап		TA TA	T						_
			21	ПСРЧ		ропоы								_
		F	22		I		I							
		╁	23		T		Ι	1						_
		H	24		T		Ι							_
			27	<u> </u>				ı						
		\perp						Разработа.	Л	Шитов Д.И.				
								Проверил Утвердил		Виноградов	А.И.			_
_		Э Д						Н. Контр						_
		πĖ						Отв. АЦП	У					_

				ОСТ 11.040.019-83 Форма 46	
					2
				ТЕИМ	C.11.03.03.18.787.00
			T	Код, наименование операции	
		-	Л/М	Наименование детали, сб.единицы или материала	
			О	Содержание операции (перехода)	Т
				1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	
				1.1 К выполнению данной операции допускаются ли	ица:
Н				- не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмот	р,
				- изучившие техническое описание и инструкци	ию по
				эксплуатации установки;	
Щ				- прошедшие инструктаж и аттестованны	е на
					авилам
				эксплуатации электроустановок потребителей» и «Пра	
-				техники безопасности при эксплуатации электроустановок	
				- прошедшие инструктаж на рабочем месте с подпи	
				журнале инструктажа.	ilebio b
					онжом
				возникновение следующих видов опасности:	МОЖНО
				·	
				-электроопасность;	
-				-травмирование рук колюще-режущие предмета	ами и
Į				компонентами;	
				- пожароопасность;	
				- напряжение зрения.	
					орпуса
				установок, которые могут оказаться под напряжением в	-
				какой-либо неисправности (нарушение целостности зазем	
				или неисправной изоляции соединительных проводов и каб	5елей).
				1.4 Травмирование рук может возникнуть при каки	х-либо
				манипуляциях руками в рабочей зоне при выполнении р	абот с
				пинцетом, а также бокорезами.	
				1.5 Источником пожароопасности является эти	иловый
				спирт при наличии открытого огня или искры, термовозд	цушная
				паяльная станция, а также возможное воспламенение уста	ановок
				при их неисправности.	
Ду	В	П			
У Б	3 A	ОД			
Л		Л			
Ш		_			

						OCT 11.0	040.019-	83	Рорма 46	5	
											3
			1						МИ	ЭТ.11.03.03.18.	787.00 OK
	T			Код, наим	иенование (операци	И				
	Л/М		Наи	менование детал							
	O			Содерж	кание опера	ации (пе	ерехода))			То
		1	.6 Источн	иком напр	яжения	зрен	ия яв	ляет	ся дли	ительная	
		работа с	с микроско	пом.							
		1	.7 Для об	еспечения	электро	безог	асно	сти г	геред	началом	
		работы	проверить	визуально	налич	ие и	целос	тнос	ть заз	емления	
		корпусс	в установ	ок пневмод	дозатор	аиу	нивер	саль	ной п	аяльной	
		станции	і, надежн	ость изоля	яции с	оедин	ителі	ьных	проі	водов и	
		кабелей	. Соблюда	ть требова	ания, и	зложе	нные	ви	нстру	кции по	
		эксплуа	тации этих	х установок	ζ.						
		C	облюдать	требовани	ия, изл	ожені	ные	в ин	нструк	сции по	
		«Охране	е труда при	и работе на	электро	оуста	новка	X».			
				бежание т							
				олнение ка							
		при про	оведении у	установкой	автома	атиче	ских	ЦИКЈ	іов. Е	3 случае	
		возникн		пасности	следуе	ет н	емедл	тенно	O OT	ключить	
		оборудо									
				ежание по							
		-		закрытом				над	пись	"спирт",	
			•	ельных при	•						
				бежание по			_			_	
				ез каждый	час ра	аооты	і дела	ать г	IMTTMI	инутныи	
		перерын		- E				- <u>~</u>	_		
			_	обнаружен		_		геи	в ус	становке	
		раооты	не произво	одить, вызв	ать нал	адчик	d.				
H 5 =											
Д В П У 3 О											
Б А Д —											
ЛМЛ											
	ОКУ		Опера	ционная карта у	/ниверсаль	ная					

					1			OCT 11.	040.019-	83	Рорма 46	5	
											МИ	ЭT.11.03.03.18.′	787.00
		_	T				именовани						
		_	Л/M О		На	пименование дет	али, сб.еди жание опе						
				2.	$OD\Gamma \Lambda 1$	деления ВИДАЕИН					TC A		
						тизация эке и монта						ю пноту	
					-		·				•	·	
				-	_	диомонтаж перации и и		_			теста		
						перации и и	імеющи	те квал	іифик	ацик	не ні	иже 4-10	
				разряда		ocarar v	у о отпо	T 0 T1141			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T011110	
					-	абочем м						данная	
				_		арта, сборо		_					
					•	становки и		румен	г, а	такж	ce pa	сходные	
				_		итная экипі	-						
					.3 Электр		гигиена		•	/част		должна	
						гребования	•	аметра	ами ми	икроі	клима	га:	
						oa - (21,5±0							
						- (45±10)%							
						оты - 100, 1							
						ологическая		да пер	сонал	а уч	астка	должна	
Į						гребования						_	
						ологическое		орудов	вание	до	ОНЖПО	быть	
						но требова						_	
				2.		виды ремо		_	-		ческих	к работ	
				проводи			записьн	o pe	зульта	тов	В	журнале	
	-					рудования							
					.5 Перечо	•	филакт			рабо		и их	
				_	_	становлень	ы в экс	плуата	ацион	ной	докум	ентации	
				на устан	•								
					-	оль прив			-	ності	и ус	тановки	
				_	-	ор в следую	ощих сл	учаях	•				
				-	1 раз в не	делю;							
					-	ионта и про	_	-					
				- 1	повышен	ная дефекті	ность, п	ю указ	ванию	техн	олога	•	
Д У	B 3	П		<u> </u>				<u> </u>					
Б	A	Д -											
Л	M	Л											

т Код наименование операции Т Код наименование операции проводить в напроновых перчатках. 2.7 Работу по выполнению данной операции проводить в капроновых перчатках. Капроновые перчатки надевать вне участка Хлопчатобумажные салфстки и перчатки хранить и транспортировать в закрытой технологической таре. 2.8 Радиоэлектронные компоненты хранить и транспортировать в закрытой технологической таре. 2.9 В случае возникновения на участке внештатной ситуации (пожара, отключение электроэнергии, изменение параметров микроклимата и т.д.) оператору необходимо немедленно доложить начальнику участка и вызвать наладчика. Дальнейшие его действия должны соответствовать требованиям, изложенным в соответствующих инструкциях по охране труда и пожарной безопасности.			C	OCT 11.040.019-83	Форма 4б	
Т Код, наименование операции Т Код, наименование операции проводить в капроновых перчатках. Содержание операции проводить в капроновых перчатках. Капроновых перчатках. Капроновых перчатки надевать вне участка. Хлопчатобумажные салфетки и перчатки хранить на участке в полизтиленовых пакетах раздельно. 2.8 Радиоэлектронные компоненты хранить и транспортировать в закрытой технологической таре. 2.9 В случае возникновения на участке внештатной ситуации (пожара, отключение электроэнертии, изменение параметров микроклимата и т.д.) оператору необходимо немедленно доложить начальнику участка и вызвать наладчика. Дальнейшие его действия должны соответствовать требованиям, изложенным в соответствующих инструкциях по охране труда и пожарной безопасности.					1 00.124 10	5
Т Код, ваименование операции Д. В II Д. В II						3
П.М Наименовывые детаци, объединацы или митериала					МИЭТ.11.03.03.18	3.787.00 OK
Содержавите операции (перехода) Сл. Работу по выполнению данной операции проводить в капроновых перчатках. Капроновые перчатки надевать вне участка. Хлопчатобумажные салфетки и перчатки хранить на участке в полиэтиленовых пакетах раздельно. Сл. В дадиоэлектронные компоненты хранить и транспортировать в закрытой технологической таре. Сл. В сл. учае возникновения на участке внештатной ситуации (пожара, отключение электроэнергии, изменение параметров микроклимата и т.д.) оператору необходимо немедленно доложить начальнику участка и вызвать наладчика. Дальнейшие его действия должны соответствовать требованиям, изложенным в соответствующих инструкциях по охране труда и пожарной безопасности.		T	Код, наименование с	операции		
2.7 Работу по выполнению данной операции проводить в капроновых перчатках. Капроновые перчатки надевать вне участка. Хлопчатобумажные салфетки и перчатки хранить на участке в полиэтиленовых пакетах раздельно. 2.8 Радиоэлектронные компоненты хранить и транспортировать в закрытой технологической таре. 2.9 В случае возникновения на участке внештатной ситуации (пожара, отключение электроэнергии, изменение параметров микроклимата и т.д.) оператору необходимо немедленно доложить начальнику участка и вызвать наладчика. Дальнейшие его действия должны соответствовать требованиям, изложенным в соответствующих инструкциях по охране труда и пожарной безопасности.		Л/М				
капроновых перчатках. Капроновые перчатки надевать вне участка. Хлопчатобумажные салфетки и перчатки хранить на участке в полиэтиленовых пакетах раздельно. 2.8 Радиоэлектронные компоненты хранить и транспортировать в закрытой технологической таре. 2.9 В случае возникновения на участке внештатной ситуации (пожара, отключение электроэнертии, изменение параметров микроклимата и т.д.) оператору необходимо немедленно доложить начальнику участка и вызвать наладчика. Дальнейшие его действия должны соответствовать требованиям, изложенным в соответствующих инструкциях по охране труда и пожарной безопасности.		O	Содержание опера	ации (перехода)		То
БАД			капроновых перчатках. Капроновые перчатки Клопчатобумажные салфетки и перчатиленовых пакетах раздельно. 2.8 Радиоэлектронные котранспортировать в закрытой техноловать в озникновения и туации (пожара, отключение параметров микроклимата и туараметров микроклимата и туараменным доложить начальнику у цальнейшие его действия должны с изложенным в соответствующих ин	надевать во рачатки хранить омпоненты погической тарем электроэнерги д.) оператору участка и вызванответствовать	не участка. та участке в хранить и е. в внештатной и, изменение необходимо ать наладчика.	
	\Box	_				<u> </u>

							OCT 11.	040.019-83	3 Форма	4б	
									M	ИЭТ.11.03.03.18.7	787.00
		T				аименовани					
	-	Л/M О			Наименование д	етали, сб.еди сержание опе			ла		-
				3. Г	ІОДГОТОЕ				TA		
					готовка раб						
					едиться, чт					я станция	
			выключ	ены.							
			3	.1.2 Про	верить в	изуально	нал	ичие	и це.	лостность	
			заземле	ния авт	оматическо	го превм	иодоза	тора и	термов	оздушной	
			паяльно								
-	+			.1.3 Вкл		•	верит	ь ра	аботосп	особность	
				_	а и паяльно						
					ключить об					ісь о его	
					урнале готс						
					тотовка раб						
_					диться по						
					борудовани 						
				-	и проверена утствии заг					_	
				-	утствии заг работе не г						
					граооте не г гучить у те	•				,	
					ласно данн						
			_		ГОТОВИТЬ	_	держа	_	рабочее	место,	
					· компонентн			•		1	
				ŕ			1		1		
i [
	В П 3 О										
у Б	В П 3 О А Д М Л										

Т Код, наименование операции Т Наименование детали, еб единиция вих материала О Содержание операции (перехода) 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 4.1 Подучить кассеты с компонентами и заготовку печатной платы у технолога. 4.1.2 Проверить по сопроводительному листу количество и соответствие электронных компонентов. 4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов. 4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки. 4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов. 4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы. 4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы. 4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы. 4.5 Приступить к операции подготовки поверхность печатной платы. 4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ. 4.5.2 В завнеимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.							C	OCT 11.	040.019-	83 4	Рорма 4	Ю.	
т Код. пальенование операции ПМ Наименование детали, сб сдиницы или материалы О Содержание операции (перехода) 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 4.1 Подучоть рабочее место для монтажа компонентов. 4.1.1 Получить кассеты с компонентами и заготовку печатной платы у технолога. 4.1.2 Проверить по сопроводительному листу количество и соответствие электронных компонентов. 4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов. 4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки. 4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов. 4.3.1 Произвести очистку заготовки печатной платы. 4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слетка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы. 4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы. 4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов. 4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ. 4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.													
											ΜI	ĬЭТ.11.03.03	3.18.787.0
Солержание операции (перехода) 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 4.1 Подготовить рабочее место для монтажа компонентов. 4.1.1 Получить кассеты с компонентами и заготовку печатной платы у технолога. 4.1.2 Проверить по сопроводительному листу количество и соответствие электронных компонентов. 4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов. 4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки. 4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов. 4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы. 4.3.1 Произвести очистку печатной платы в еледующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы. 4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы. 4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов. 4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ. 4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.		T			К	од, наиме	нование о	пераці	и				
4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 4.1 Подготовить рабочее место для монтажа компонентов. 4.1.1 Получить кассеты с компонентами и заготовку печатной платы у технолога. 4.1.2 Проверить по сопроводительному листу количество и соответствие электронных компонентов. 4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов. 4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки. 4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов. 4.3.1 Произвести очистку печатной платы. 4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы. 4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы. 4.5.1 Гриступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов. 4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ. 4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.		Л/М]	Наименован	ие детали	, сб.един	ицы ил	и матери	ала			
4.1 Подготовить рабочее место для монтажа компонентов. 4.1.1 Получить кассеты с компонентами и заготовку печатной платы у технолога. 4.1.2 Проверить по сопроводительному листу количество и соответствие электронных компонентов. 4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов. 4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки. 4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов. 4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы. 4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; крутовыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы. 4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы. 4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов. 4.5.1 Разделить планку пітыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ. 4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.	-	О											
4.1.1 Получить кассеты с компонентами и заготовку печатной платы у технолога. 4.1.2 Проверить по сопроводительному листу количество и соответствие электронных компонентов. 4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов. 4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки. 4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов. 4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы. 4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы. 4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы. 4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов. 4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ. 4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			4	. TEXH	ОЛОГИ	ЧЕСК	ИЙ ПР	ОЦЕ	CC				
печатной платы у технолога. 4.1.2 Проверить по сопроводительному листу количество и соответствие электронных компонентов. 4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов. 4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки. 4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов. 4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы. 4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы. 4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы. 4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов. 4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ. 4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			4	.1 Подг	отовить	рабоче	е мест	о для	н монт	ажа 1	комп	оненто	В.
4.1.2 Проверить по сопроводительному листу количество и соответствие электронных компонентов. 4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов. 4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки. 4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов. 4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы. 4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы. 4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов. 4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ. 4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.				4.1.	1 Получ	ить ка	ссеты	с ко	мпоне	нтам	ииз	ваготові	ку
количество и соответствие электронных компонентов. 4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов. 4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки. 4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов. 4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы. 4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы. 4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы. 4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов. 4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ. 4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			П	ечатной	платы у	техно.	пога.						
4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов. 4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки. 4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов. 4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы. 4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы. 4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы. 4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов. 4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ. 4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.				4.1.	2 Прове	рить	ПО	сопр	оводи	итель	ному	и лис	гу
технологических материалов. 4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки. 4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов. 4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы. 4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы. 4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы. 4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов. 4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ. 4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			К	оличесті	во и соот	гветств	ие эле	ктро	нных	комп	онен	тов.	
4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки. 4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов. 4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы. 4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы. 4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы. 4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов. 4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ. 4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.				4.1.	3 Прове	рить	налич	ие і	трочи	X Ou	ища	ющих	и
капроновые перчатки. 4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов. 4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы. 4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы. 4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы. 4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов. 4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ. 4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			T	ехнологі	ических	матери	алов.						
4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов. 4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы. 4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы. 4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы. 4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов. 4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ. 4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.				4.1.	4 Монта	ажнику	и надет	гь ан	гистат	ичес	кий (браслет	И
компонентов. 4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы. 4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы. 4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы. 4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов. 4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ. 4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			К	апронов	ые перча	атки.							
4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы. 4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы. 4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы. 4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов. 4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ. 4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			4	.2 Визуа	ально	провеј	оить	цело	остнос	сть	элен	строннь	JIX
4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы. 4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы. 4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов. 4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ. 4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			компон	ентов.									
следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы. 4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы. 4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов. 4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ. 4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			4	.3 Прои	звести о	чистку	загот	овки	печат	ной г	ілать	I.	
бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы. 4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы. 4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов. 4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ. 4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.				4.3.	1 Произ	вести	очио	стку	печа	атной	я́ п	латы	В
поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы. 4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы. 4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов. 4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ. 4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			c.	ледующ	ем поряд	дке: сл	егка п	ропи	гать х	лопч	атобу	умажну	то
протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы. 4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы. 4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов. 4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ. 4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			б	язь этил	овым сп	иртом;	круго	вымі	и двих	кения	ими п	ротере	ГЬ
печатной платы. 4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы. 4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов. 4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ. 4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			П	оверхно	сть пе	чатной	пла	ты	проп	итані	ной	тканы	o;
4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы. 4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов. 4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ. 4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			П	ротереті	ь чистой	і́ хлоп	чатобу	/маж	ной б	маєк	ПОВ	ерхнос	ТЬ
платы. 4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов. 4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ. 4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			П	ечатной	платы.								
4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов. 4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ. 4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			4	.4 Визуа	ально пр	овери	гь цел	остно	ость за	агото	вки	печатно	ой
монтируемых компонентов. 4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ. 4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			платы.										
4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ. 4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			4	.5 Прис	тупить	к опе	ерации	ПО,	дготов	вки	пове	рхності	Ю
части бокорезами в соответствии с ПЭ. 4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			монтир	уемых к	омпонен	нтов.							
4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.				4.5.	1 Раздел	лить г	ланку	ШТ	ыревы	X BI	илок	PLS 1	на
произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			Ч	асти бок	орезами	в соот	ветств	вии с	ПЭ.				
Д В П У 3 О Б А Д				4.5.	2 В зав	висимо	сти от	г ви,	да ра	зъема	a mi	cro US	$ \mathbf{B} $
ДВП УЗО БАД			п	роизвест	ги вырав	вниван	ие сило	овых	ноже	к пло	ског	убцами	.
У 3 O Б A Д			4	.6 Дозиј	рованно	е нанес	ение г	ірипо	ойной	паст	Ы.		
У 3 O Б A Д													
У 3 O Б A Д								ı					
	У 3 О												

								(OCT 11.	040.019	-83	Форма 4	4б	
														8
						I						М	жэт 11 02 02	19.797.00.01
												IVII	AЭТ.11.03.03	.16./6/.000
		-	Т					именование						
		-	Л/М О			наи	менование дет	али, со.един						То
		-			1	6 1 I	Поместит	•	`	•	·	IOTII I	ио столи	
				M	икросі			5 3a1010E	sky iic	чатно	JYI 11J.	іаты і	на СТОЛИ	
					4.	.6.2	Установит	ть тюби	к с	прип	юйно	ой па	астой н	ıa
				ра			нструмент							
				•) ND-35.							
					4	.6.3 I	Включить	пневм	олоза	тор	нажа	в на	ь кнопк	·v
				~ (0	ON/OI				одози	Top	11007110			
					4	6.4	Вадать ог	ітималы	ное н	колич	ество	о до	зируемо	й
				Па	асты,	вра	щая руч	ку «Р»). O	птима	ільні	ым (считаетс	я
				К	оличес	тво,	при ко	тором і	паста	пол	ност	ью з	заполня	т
-				к	онтакт	ную	площадк	у, и при	этом	не ра	стека	ается	по масн	æ
				П	ечатно	й пл	ате.							
					4.	.6.5 I	Нанести	несколы	ко п	робнь	IX I	103 I	іасты н	ıa
-				П1			/ю конта			_				
				_	-		ания, убе	•		•				
							ькой КП.		,	,				
L							Удалить п	побные	лозы	чистс	й сх	хой б	วัสรษю	
							Троизвест	_			•			nR
				П			ажатием	-						
					_		ажатием 1-8) в вер:		•	_			-	/Y1
				11]	_		-						_	
							Приступи		-		_			
							ечатной і							
				•	азных	_	вмеров,	-			•	ание	следуе	
, T							ичество д				_			
							нанесенну							Й,
				cy			и повтор							
							Этключит		матич	іескиї	й п	невм	одозато _]	p,
				На	ажав н	а кн	опку «ON	/OFF».						
Д	В	П		ı			1		1	T.	ı			
У Б	3 A	ОД												
Л	M													
		-					1			-				<u> </u>

			ОСТ 11.040.019-83 Форма 46	
			МИЭТ.11.03.03.18.	707 (
				/6/.
		T 	Код, наименование операции Наименование детали, сб.единицы или материала	
		O	Содержание операции (перехода)	
			4.7 Произвести контроль качества нанесения припойной	
			пасты. Неудачно, нанесенную пасту следует удалить чистой,	
			сухой бязью, затем снова нанести пасту на очищенный участок.	
			4.8 Приступить к операции дозирования клеевой	
			композиции.	
			4.8.1 Закрепить тюбик с клеем на рабочем	
			инструменте дозатора.	
-	+		4.8.2 Включить пневмодозатор, нажав на кнопку	
			«ON/OFF».	
			4.8.3 Настроить дозу клеевой композиции опытным	
			методом, поворачивая ручку «Р». Количество дозы клея	
			должно быть таким, чтобы нанесенный клей на проекцию	
-			середины корпуса, самого мелкого компонента, не	
			растекался на контактные площадки этого компонента.	
-			4.8.4 Запомнить дозировку клея, нажав на	
			произвольный номер программы (номер программы не	
			должен совпадать с номером программы при дозировании	
			припойной пасты) в верхней части дозатора.	
			4.8.5 Произвести нанесение клея, руководствуясь	
			шелкографическим рисунком на заготовке печатной платы.	
			Наносить пасту стоит на середину проекции корпуса на	
			ПП. Количество доз может меняться в зависимости он	
			площади и веса радиоэлектронного компонента.	
			4.9 Произвести контроль качества нанесения клеевой	
			композиции. При наличии растекшегося клея, произвести его	
			очистку чистой, сухой хлопчатобумажной тканью в месте	
			растекания. Затем, повторно нанести клей на это место.	
			4.10 Приступить к сборке компонентов на заготовку	
			печатной платы.	
Ду		Π		
У Б		ОД		
Л	M			
_		_		

		ОСТ 11.040.019-83 Форма 4б	
			10
		MIJT.11.03.03.18.78	87.00 OF
	T	Код, наименование операции	
	Л/М	Наименование детали, сб.единицы или материала	
	О	Содержание операции (перехода)	То
		4.10.1 Удобно расположить кассеты с компонентами	
		на рабочем месте.	
		4.10.2 В соответствии со сборочным чертежом (СБ)	
		произвести сборку SMD компонентов на печатную плату.	
		Сборка SMD компонентов производится пинцетом. Для	
		удобства работы с мелкими чип компонентами можно	
		использовать микроскоп. Важно учитывать ориентацию	
		некоторых компонентов.	
		4.10.3 В соответствии со СБ произвести сборку	
		традиционно- монтируемых компонентов.	
		4.11 Операция контроля качества сборки печатной платы.	
		Визуально оценить качество сборки, сравнить ПП со сборочным	
		чертежом. При наличии дефектов или несоответствий,	
		произвести подгонку или переустановку компонента.	
		4.12 Монтаж компонентов на плату.	
		4.12.1 Включить термовоздушный паяльный фен, в	
•		составе станции ELEMENT 702 переключив тумблер	
		«ПИТАНИЕ» в левой части паяльной станции в состояние	
		«ВКЛ».	
		4.12.2 Установить на минимум интенсивность	
		воздушного потока, повернув ручку «ВОЗДУХ» в крайнее	
		левое положение.	
		4.12.3 Установить температуру паяльного фена	
		равной 200 °C. Для этого, необходимо установить значение	
		«200» на левом цифровом индикаторе, используя кнопки	
		«ВВЕРХ» и «ВНИЗ», находящиеся под цифровым	
		индикатором.	
Д В П У 3 О			
БАД			
Л М Л			
	ОКУ	Операционная карта универсальная	

		ОСТ 11.040.019-83 Форма 46	
			1
		MEDITION	10.707.00
		МИЭТ.11.03.03	.18./8/.00
	T	Код, наименование операции	
	Л/M О	Наименование детали, сб.единицы или материала Содержание операции (перехода)	Т
		4.12.4 Плавными круговыми движениям	
		обрабатывать поверхность печатной платы до начал	
		процесса кристаллизации клеевой композиции. Опытны	
		путем, и методом смещения компонентов пинцетов	
			vı,
		определить затвердел ли клей.	70
		4.12.5 Установить температуру термовоздушног	. 0
		паяльного фера равной 240°С. 4.12.6 Плавными круговыми движениям	
		13	
		обрабатывать ПП горячим воздухом до момент	
		кристаллизации припойной пасты. Момен	
		кристаллизации можно определить визуально, припойна	я
		паста поменяет цвет и консистенцию.	
		4.12.7 Отключить термовоздушный паяльный фен	
		переключив тумблер «ПИТАНИЕ» в левой части паяльно	М
		станции в состояние «ВЫКЛ».	
		4.12.8 Дождаться момента, когда печатная плат	га
		остынет и приобретет комнатную температуру.	
		4.13 Произвести контроль качества монтажа.	
		4.13.1 Произвести визуальный контроль качестн	за
		паяных соединений.	
		4.13.2 При обнаружении дефекта монтажа следуе	
		провести его анализ и устранение. В процессе устранени	Я
		дефекта необходимо пользоваться паяльниког	м,
		присутствующем в составе паяльной станции.	
		4.14 Провести выходной контроль функциональност	ги
		отдельных узлов ПП. Для этого необходимо использоват	ГЬ
		универсальный цифровой мультиметр. Порядок работы	c
		прибором Mastech M9508:	
ДВП УЗО			
У 3 О Б А Д			
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$			
	ОКУ	Операционная карта универсальная	<u> </u>

Т Кол, нависенование операция ЛУМ Наисепование астоли, об салинцы или митериала О Содержание операции (переходая) То 4.14.1 Включить мультиметр, нажав на кнопку «ОN». 4.14.2 Установить щупы в гнезда «СОМ» и «V/Онт/Иг». 4.14.3 Повернуть переключатель режимов работы, находящийся в центре прибора, в режим измерения сопротивления (диапазон измерений подбирается индивидуально для конкретной провержемой цепи). Проверить функциональность изделия, подключив минимально необходимую периферию и шитапие. 4.15 Упаковать устройство в тару, передать технологу. 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ 5.1 Микроехемы собираются на печатную плату с учетом ориентации корпуса, ключ в виде точки на корпусе микроехемы должен располагаться в непосредственной близости к точке на шелкографическом рисунке. 5.2 Термовоздушный паяльный фен отключается при нахождении на подставке, поэтому чтобы заработал компрессор необходимо снять рабочий инструмент с подставки. 5.3 Допускается изменять температуру паяльного фена в пределах 20°C от указанной, для подбора оптимального время кристаллизации материалов.			ОСТ 11.040.019-83 Форма 46	
Т Кот, наименование операции ЛМ Наименование детали, сб.единицы или материала О Содержане операции (перехода) То 4.14.1 Включить мультиметр, нажав на кнопку «ОN». 4.14.2 Установить шупы в гнезда «СОМ» и «V/Оhm/Hz». 4.14.3 Повернуть переключатель режимов работы, находящийся в центре прибора, в режим измерения сопротивления (диапазон измерений подбирается индивидуально для конкретной проверяемой цепи). Проверить функциональность изделия, подключив минимально необходимую периферию и питание. 4.15 Упаковать устройство в тару, передать технологу. 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ 5.1 Микросхемы собираются на печатную плату с учетом ориентации корпуса, ключ в виде точки на корпусе микросхемы должен располагаться в непосредственной близости к точке на шелкографическом рисунке. 5.2 Термовоздушный паяльный фен отключается при нахождении на подставке, поэтому чтобы заработал компрессор необходимо снять рабочий инструмент с подставки. 5.3 Допускается изменять температуру паяльного фена в пределах 20°C от указанной, для подбора оптимального время кристаллизации материалов.				12
			MI/FT.11.03.03.18.78	87.00 OK
ММ Наименование детали, еб.единицы или материала То		T	Код, наименование операции	
4.14.1 Включить мультиметр, нажав на кнопку «ОN». 4.14.2 Установить щупы в гнезда «СОМ» и «V/Ohm/Hz». 4.14.3 Повернуть переключатель режимов работы, находящийся в центре прибора, в режим измерения сопротивления (диапазон измерений подбирается индивидуально для конкретной проверяемой цепи). Проверить функциональность изделия, подключив минимально необходимую периферию и питание. 4.15 Упаковать устройство в тару, передать технологу. 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ 5.1 Микросхемы собираются на печатную плату с учетом ориентации корпуса, ключ в виде точки на корпусе микросхемы должен располагаться в непосредственной близости к точке на шелкографическом рисунке. 5.2 Термовоздушный паяльный фен отключается при нахождении на подставке, поэтому чтобы заработал компрессор необходимо снять рабочий инструмент с подставки. 5.3 Допускается изменять температуру паяльного фена в пределах 20°C от указанной, для подбора оптимального время кристаллизации материалов.		Л/М	•	
«ОN». 4.14.2 Установить пупы в гнезда «СОМ» и «V/Ohm/Hz». 4.14.3 Повернуть переключатель режимов работы, находящийся в центре прибора, в режим измерения сопротивления (диапазон измерений подбирается индивидуально для конкретной проверяемой цепи). Проверить функциональность изделия, подключив минимально необходимую периферию и питание. 4.15 Упаковать устройство в тару, передать технологу. 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ 5.1 Микросхемы собираются на печатную плату с учетом ориентации корпуса, ключ в виде точки на корпусе микросхемы должен располагаться в непосредственной близости к точке на шелкографическом рисунке. 5.2 Термовоздушный паяльный фен отключается при нахождении на подставке, поэтому чтобы заработал компрессор необходимо снять рабочий инструмент с подставки. 5.3 Допускается изменять температуру паяльного фена в пределах 20°С от указанной, для подбора оптимального время кристаллизации материалов.		0	Содержание операции (перехода)	То
нахождении на подставке, поэтому чтобы заработал компрессор необходимо снять рабочий инструмент с подставки. 5.3 Допускается изменять температуру паяльного фена в пределах 20°С от указанной, для подбора оптимального время кристаллизации материалов.			4.14.1 Включить мультиметр, нажав на кнопку «ON». 4.14.2 Установить щупы в гнезда «COM» и «V/Ohm/Hz». 4.14.3 Повернуть переключатель режимов работы, находящийся в центре прибора, в режим измерения сопротивления (диапазон измерений подбирается индивидуально для конкретной проверяемой цепи). Проверить функциональность изделия, подключив минимально необходимую периферию и питание. 4.15 Упаковать устройство в тару, передать технологу. 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ 5.1 Микросхемы собираются на печатную плату с учетом ориентации корпуса, ключ в виде точки на корпусе микросхемы должен располагаться в непосредственной близости к точке на шелкографическом рисунке.	10
	У 3 С Б A Д		нахождении на подставке, поэтому чтобы заработал компрессор необходимо снять рабочий инструмент с подставки. 5.3 Допускается изменять температуру паяльного фена в пределах 20°C от указанной, для подбора оптимального время	
		_		



								ГОСТ 3	3.1118-8	32 Ф	орма 4			
												7		1
										МИ	ЭТ.11.03	3.03.18.78	37.00	MK
		М	одуль	програ	MMM	nuem	OEO EM	роста	бипиз	atona				
	В	Цех	Уч	PM		пер	ого ги			вание оп	ерации			
	Γ			1	(- Обознач	нение дог	кумента						
	Д	CM	TT 1				ование о			TC	T =	T		
	Тп.з Л/М	CM	Проф	Р Наимеі	УТ новани	КР е летал	КОИД и, сб. еди	ЕН	ОП пи матер	К _{шт} иала	Тп.з.	Тшт		
	H/M		Об	означени		дотак	., • • • • • •	ОПП	EB	EH	КИ	H _{pacx}		
	01	1		1										
	Γ 02	Настоя	щий	мар	шрут	<u>Ι</u>	опред	еляет	П	ослед	овател	ьность		
	03	выполн		1			1			1		1		
	04	модуля		1			1	-		1	1	1		
	05								1			1		
	Γ 06	ГОСТ 1	12.3.03	2-84, 1	OC	12.3	.002-7	75				1		
_	07	1										1		
	Γ 08	1	. Общ	ие тех	ниче	ские	требо	вания.				1		
	09	1.1. Печ			!	!	!		:	и монт	аж. ло	і ЛЖНЫ		
	10	соответ												
	11	ГОСТ2		1	1	1	1		1	1	1			
	12	отметко										1		
		1.2. Bc		1	1	1	1		1	DRy.		1		
	14	(электр		1			1			бороч	ные уз	шы)		
	15	должны		1	1	1	1		:	1	1	1		
	16	соответ								_	І П			
	17	констру		1	1	1		iwi yesi		VI FIJIFI				
	 18	1.3. Ha		1	1	1	1	шие из	елепия	т попж	HLI	1		
	19	находи		1	. 10 KC		1	TIIO II	.д. - л. 1117	. доли		1		
	20	1.4. Пр		-	и nal	От 33	преш	ается	испол	LSUBS 1	Ъ	1		
	21	неиспр		1	1	1	1		1	ושפטכעו	ע	1		
	22	1.5. Of		ипотр	y MCE	OHOUT	mecko	a octro	y. ICTV2 1	и спел	СТРЗ			
	23	измере			1		1		1			ПИ		
	23	измере	шил, Щ	PHIMICHY	I CIVIDI	С ДЛЯ	ъвито.	тисни.	n one	лации	Соорки	1 Y1		
	۷ 11													
					1		Разраб			ов Д.И				
					+		Провер		Вино	градов А	.И.			
					+		Утверд Н.конт				$\overline{}$			
							тт.коп1	۲۰						
	 МК					Марші	рутная ка	арта						
						r		•						

 						ГОСТ 3	3.1118-8	32 Форм	иа 3б		
											2
-								МИ	ЭТ.11.03	3.03.18.78	87.00 MK
В	Цех	Уч.	PM	Опер			наимено	вание оп	ерации		
ГД				Обозна Код, наимен		окумента	апиа				
E	CM	Проф	P	УТ КР	коид		ОП	Кшт	Тп.з	Тшт	
Л/М			Наиме	енование дета.	пи, сб.ед	иницы ил	и матер	иала			
H/M	1	Об	означени	е, код	1	ОПП	EB	EH	КИ	H _{pacx}	
1	и монт	гажа пл	ат, дол	іжны быт	ь атте	стован	ы.			1	
2	1.6. Пр	ои выпо	лнени	ии работ с	облю	дать тр	ебова	ния по	защи	те от	
3	статич	еского	электр	оичества і	и рабо	тать с	антис	татиче	ским		
4	брасле	стом в с	оотве	гствии с т	ребов	ваниям	и ГОС	CT 12.3	3.032-8	34.	
5	1.7. До	начала	а рабо	ты по мон	тажу	плат п	ровер	ить те	мпера	гуру	
6	воздух	ка термо	і овозду	шной пая	і льной	і станц	; (ии. В	еличиі	на	1	
7	превы	шения	над те	мператур	ой нач	нала кр	истал	лизаці	ии при	ПОЯ	
8	(45-80) °С зав	висит (от массы 1	аяем	ого изд	целия,	време	ни пай	іки,	
9				іловому в						1	
10				иях (ТУ) н			l		1	1	
11				ы LFM-48			мпера	атура н	ачала	1	
12				оответств						М.	
13				ура пайки		1					
14				ого клея J							
15				ется 170 °							
16				ь увеличе						1	
17				а воздуха		1_		чена с)T	1	
18				пения при			1			1	
19				чем 20-30			1			1	
20	1			годом и ра		1	1		l	1	
21		нтами).			1						
22			иперат	гуры возд	VIIIHOI	го потс	ка пр	оизвол	ится	1	
23				луры возду Мовоздуш:						ЭННЫМ	
24				гка об уст						1	
25				ся в журна				ратур	Возд	I	
26	HOTORU	произ	одит	и в журпс	inc Ro	11170317				1	
20											
МК			Ma	аршрутная кар	та						

	ГОСТ 3.1118-82 Форма 36												
													3
	1									МИ	ЭТ.11.03	3.03.18.78	87.00 MK
	В	Цех	Уч.	PM	Oı	тер		Код,	наимено	вание оп	ерации		
	Γ						нение дог						
	<u>Д</u> 	CM	Проф	P	Код, 1	_	ование о КОИД	оорудов ЕН	ОП	Кшт	Тп.з	Тшт	
	Л/М	CIII	11704						пи матері		11115	- 1111	
	H/M		Об	означени	е, код			ОПП	EB	EH	КИ	H _{pacx}	
	1	Время	оплавл	і Іения і	трипс	ойной	і пасті	ы и те	ермиче	еской (брабо	ТКИ	
	2	клея по									1		
	3	качест									1		
	4	1.10. T	ребова	ния к ч	услов	зиям :	произі	водст	н Ва и пр	завила	ιих		
	5	соблюд									1		
	6							1210			1		
	B 7				005		Комг	ілекто	овочна	ія			
	8	1					1101111				1		
	Γ 9	ГОСТ	12.3.03	32-84.	ГОСТ	Г 12.3	3.002-	75			1		
	10	1	12.0.00	1		120		, c			1		
	Д 11	Стол м	онтажі	ника Р	ЭА А	PM-	4110				1		
	12										1		
	T 13	Брасле	ет анти	статич	ески	й ЈТ-	97-081				1		
<u> </u>	T 14		ехноло								1		
	15	1		1							1		
	Γ 16	Опера	цию пр) ОВОЛИ	ть с с	собль	оление	ем тре	ебован	ий ГО	CT 12.	3.002-	
	17	75	<u> </u>	Говодп			эдоппо	111 150				2.002	
	18	13		1							1		
	O 19	Компт	іектова	TE HOU	еппа	COPTO	OCHO CI	теппл	MKSIII	TTX	I		
	20	IXUMIIIJ	ICKIUBA	то изд	KINILO	COLII	icho Cl	тециц	ункац!	ırı.	1		
	_	Пест			0 ===	WILL T	OMOTE	T IT CONTINUE		0.110.1111	בית ב		
			рить пе				_						
	22		схемы										
	23	1	тветсті	1					-				
	24		ентов,	ŀ				однос	ть и с	рок вь	іпуска		
	Γ 25	Разлох	кить ко	мплек	туюц	цие в	тару.				1		
	26												
	MK			Ma	ршрутн	ная кар	та						

								ГОСТ	3.1118-	-82 Фо	орма 3б		
													4
										МИ	ЭТ.11.0 .	3.03.18.78	87.00 MK
	В	Цех	Уч.	PM		іер			наимено	вание ог	герации		
	<u>Г</u> Д						нение до		a				
	E	CM	Проф	P	УТ		КОИД	ЕН	ОП	Кшт	Тп.з	Тшт	
	Л/М			Наиме	новани	е детал	и, сб.еди	ницы ил	и матер	иала			
	H/M		Об	означени	е, код		1	ОПП	EB	EH	КИ	H _{pacx}	
	Γ 1	На пок	зупные	ЭРЭд	должі	на бы	іть соі	провод	цителі	ьная д	окумен	тация	
	2	о прохо	эждени	и вход	дного	конт	роля (соглас	но тр	ебоваі	ниям Г	OCT	
	3	12.3.03	2-84.	İ			İ	İ			İ		
	4						i	i			i		
	B 5				010		Подг	отовк	а ПМ	К			
\vdash	6												
	T 7	Бокоре	зы ТО]	PEX 3	2D10	6							
	8	1											
	O 9	Произн	вести п	азлепе	ение і	тпань	си PLS	5-40 н	а част	ивсо	ОТВЕТС	гвии	
	10	со спе				IJI GIII			1401	пвс	I		
	11		тфтка	щиси.							1		
	B 12	1			015		Опис	стка п	-иятиі	лу ппа) AT		
	13	1			013		O III	I Ku II	o lallil	317X 1131C	11		
	Л 14	Спирт			ктифі							ГОСТ	
	15	P 5587			Пифи	IKODa	IIIIIDIYI	CAIII	-ICCRP	in wor		001	
	Л 16				ONCHI	10 00	пфоти	TT (400	×400)	NOV. C	200*20	0) 204	
	17	Ткани			ажны	ic, ca.	пфетк	и (4 00	(X 4 00)	мм, (.	<u> </u>	U) MM	
		ГОСТ	<u> </u>	03	1 1						1		
	18	1 17									1		
	O 19	_									лфетки	l,	
	20	предва		İ			i .	i .			1		
	O 21	2. Про	сушиті	ь платі	ы, исі	польз	зуя хло	опчато	бума	жную	ткань.		
	22										1		
	B 23				020		Нане	сение	прип	ойной	і пасты	[
	24										1		
	Д 25	Полуан	втомати	ически	ій про	ВМОД	отато	p ND-	35.				
	26				. ,					•			
		•											
	МК			Ma	іршруті	ная кар	та						

,	ГОСТ 3.1118-82 Форма 36												
													5
										МИ	ЭТ.11.03	3.03.18.78	87.00 MK
	В	Цех	Уч.	PM	Oı	іер		Код,	, наименс	вание оп	ерации		
	Γ							кумента					
	<u>Д</u> Е	CM	Проф	Р	Код, в		ование о КОИД	оборудог ЕН	вания ОП	Кшт	Тп.з	Тшт	
	Л/М	Civi	Проф				/ 1		ли матер		111.5	1 IIIT	
	H/M		Об	означени				ОПП		ЕН	КИ	H _{pacx}	
	O 1	1. Про	извести	і и нане	сение	приі	тойнс	рй пас	ты LF	M-48L	J MDA	<u>-</u> 5	
	2	полуав		1				1					
	3	Нанес		l	1 1				i i	l		КУ	
	4	всех ко						1					
	5	площа,									1		
	6	111101114,	Ann on				рине				1	1	
	B 7				025		Сбор	- эка Т1	ИК и I	ІМК	1		
	Д 8	Полуаг	втомати	ически	ій пре	ВМОД	озатс	p ND	-35.		1		
	9	1		1							1		
	O 10	1. Уста	новить	тюби	кскј	пеем 1	на соі	пло пі	невмат	ическо	т ОГО ДОЗ	ватора.	
	O 11	2. Про	извести	і и нане	сение	клея	на п	нечатну	ую пла	: атув м	еста		
	12	крепле		l .							1		
	O 13	3. Про				ирова	ние к	омпо:	нентов	в на пл	ате в		
	14	соотве	тствии	с черт	ежом	т МИ	ЭТ.11	.03.03	3.18.78	7.00.0	0 СБ.		
	O 15	4. Нагр	эеть па	яльны	й фен	г до т	емпер	атурі	ы 170-	200 °C	 (′•		
	O 16	Уста	новить	ОПТИР	мальн	гую и	нтенс	: СИВНО:	сть по	: гока го	і эрячего))	
	17	воздух		1							1		
	O 18	6. Пос) 0 pa30]	греть	печа	ГНУЮ	плату	в мес	тах кр	еплені	I RN	
	19	КОМПОН								•	1		
	20										1		
	21							l					
	22	-									1		
	23	1									1		
	24	1		l				1	1		1		
	25												
	26	1									1	1	
		<u> </u>											
	МК			Ma	ршрутн	іая кар	та						

									ГОСТ	3.1118-	-82 Фо	рма 3б		
														6
											Ми	'TT11 ()	2 02 10 7	97 00 NATA
		_											3.03.18./	87.00 MK
		<u>В</u>	Цех	Уч.	PM		пер				вание оп	ерации		
		Д						вание до						
		E	CM	Проф	P	УТ		коид	ЕН	ОП	Кшт	Тп.з	Тшт	
		Л/М			Наиме	еновани	е детал	и, сб.еди	ницы ил	ти матері	иала		•	
		H/M		06	бозначени	іе, код			ОПП	EB	EH	КИ	H _{pacx}	
		1			!	030		Конт	роль 1	качест	ва сбс	рки	!	
		2		I	1	1			I	1	I	1	1	
		Д з	Микр	оскоп А	льтам	и LC	D			1		1		
		T 4	Скалі	ьпель мо	нтажн	ный э.	лектр	отехн	ическ	сий.				
		5			1							1		
ŀ		O 6	1. Пре	оизвесті	і и контр	оль і	качес	гва мс	нтаж	а изде	лия, и	 СПОЛЬЗ	вуя	
		7		овой ми						1		1	1	
		8		дены в						1		1		
		O 9	2. Пр	и обнар	ужени	и не н	качес	гвенно	ого по	зицис	они р он	зания		
		10	_	нализир		1					_		ядке:	
ŀ		11		атно по								1	1	
		12		девшег										
		13	повто	рную с	борку	этого	комг	онент	га на 1	течатн	іую пл	ату.		
_		14												
		B 15			1	035		Монт	гаж П	МК и	ТМК			
		16												
		Д 17	Паяп	ьная ста	ниия Е	ELEM	IENT	702		1				
		18	1100101	511471 C 14	111111111111111111111111111111111111111		LLIVI	702		1		1	1	
Т		O 19	1. Pas	вогреть	паяпьн	ый ф	ен. ло) темп	ienaty	ры 22	0-240	°C.	1	
		O 20		гановит						Î			0	
	+	21	возду			.1471DI	1 10 H	1110110	1151100	15 110	. Onu IV		1	
		O 22		ли. степенн	(O 1)830	грева	ть ко	мпоне	нты і	по нач	ала ог	і ілавпеі	ния	
		23		ойной п	1	Грева	LD RO	.1110110	, 1	10 114 1				
	+	23	приш	omion II	ac IDI.	1				1		1	1	
		25				1				1		1		
		26			1					1		1	1	
		20												
•	•	МК			Ma	аршруті	ная кар	га						

